

苏州锴威特半导体股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
网上发行申购情况及中签率公告

保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

特别提示

苏州锴威特半导体股份有限公司（以下简称“锴威特”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕1512号）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数为18,421,053股。本次发行初始战略配售数量为921,052股，占本次发行总数量的5.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至主承销商指定的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为921,052股，占本次发行总数量的5%。初始战略配售与最终战略配售股数相同，不向网下回拨。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为12,250,001股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70%；网上发行数量为5,250,000股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的30%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共17,500,001股。网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据网上、网下回拨情况确定。

本次发行价格为40.83元/股，锴威特于2023年8月8日（T日）通过上海

证券交易所交易系统网上定价初始发行“锴威特”A股5,250,000股。

敬请投资者重点关注本次发行缴款环节，并于2023年8月10日（T+2日）及时履行缴款义务：

1、网下获配投资者应根据2023年8月10日（T+2日）披露的《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金，资金应于2023年8月10日（T+2日）16:00前到账。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2023年8月10日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不低于扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

2、本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的70%时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、网下和网上投资者获得配售后，应按时足额缴纳新股认购资金。全部有效报价配售对象必须参与网下申购，有效报价网下投资者未参与申购或未足额参

与申购，以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为3,533,975户，有效申购股数为16,544,193,500股。网上发行初步中签率为0.03173319%。配号总数为33,088,387个，号码范围为100,000,000,000-100,033,088,386。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购倍数为3,151.27倍，超过100倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的10.00%（向上取整至500股的整数倍，即1,750,500股）股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为10,499,501股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的60.00%；网上最终发行数量为7,000,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的40.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.04231394%。

三、网上摇号抽签

发行人与主承销商定于 2023 年 8 月 9 日（T+1 日）上午在上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于 2023 年 8 月 10 日（T+2 日）在《网下初步配售结果及网上中签结果公告》及上交所网站（www.sse.com.cn）公布网上摇号中签结果。

发行人：苏州锴威特半导体股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

2023年8月9日

（此页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

苏州锴威特半导体股份有限公司



（此页无正文，为《苏州锴威特半导体股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

2023年8月9日

